

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司

2019年01月08日投资者关系活动记录表

编号：2019-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华金证券
时间	2019年1月8日 15:00
地点	公司本部二期五楼7号商务会议室
上市公司接待人员姓名	李丽杰、刘玉婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议主要介绍了公司的发展战略，核心竞争优势，产品与业务情况，以及未来发展方向，并就调研投资者关心的问题进行了解答。</p> <p>1、 公司基本情况介绍</p> <p>公司成立于1985年，经过30多年的发展，目前业务主要涵盖集成电路半导体封装与测试、计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗设备等各类高端电子产品的先进制造服务以及计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产，公司也在积极布局新能源汽车电子等战略性新兴产业。</p> <p>作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，深科技将在现有EMS核心业务基础上，通过推进智能制造持续优化先进制造管理体系，夯实公司EMS核心能力，并在保持现有计算机与存储及其相关产业制造服务优势的同时，着力提升管理和运营效率，不断发展壮大通讯与消费电子、医疗设备以及自主产品等业务。同时，通过自主创新与投资并购等方式，优化产业结构，加大力度布局集成电路半导体封装与测</p>

试和新能源汽车电子等战略性新兴产业，力争实现经营业务的稳步增长。

关于集成电路业务：公司于 2015 年收购沛顿后，经营业务继续保持了稳步发展，沛顿科技现有产品包括内存芯片 DRAM 和移动存储封装芯片和嵌入式存储芯片/嵌入式多功能芯片，产品下游应用于台式电脑、笔记本电脑、网络服务器、U 盘、智能手机及平板电脑等。深科技具有良好的产业基础、客户群体以及优秀的国际化管理团队，而沛顿的芯片技术处于同行业先进地位。未来十年是中国集成电路芯片产业特别是高端集成电路产业实现突破性发展的关键时期，而集成电路与封装领域是作为公司重要的战略目标来积极推动的。

关于计算机存储业务：个人电脑需求逐年下滑，固态硬盘市场份额的持续扩大致使传统硬盘市场出货量继续萎缩，受其影响，公司的硬盘磁头及相关产品业务也有不同程度的下降。但在数据安全和容量需求领域，全球“云计算”大量的数据快速增长，带动不同规模数据中心的迅速扩张，因此也带动了一定的传统硬盘需求，与其相关的硬盘盘基片业务因市场生产厂商日少，市场需求强劲，客户呈增加趋势。同时公司积极调整产品结构，引入固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链，并通过内部管理提升，实施精益生产以及进一步提升全产线自动化率等措施，降本增效，保持该业务的盈利能力。

关于计量系统业务：公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务，公司不断加快走出去步伐。在欧洲、东南亚、中亚及非洲地区，市场开拓不断取得突破，与多个国家的客户达成战略合作关系，并获得多个国家试点订单，为后续业务的持续增长奠定了基础。

2016 年初，公司在成都设立了控股子公司，同时引入事业部核心骨干员公司持股 30%，成都将成为公司重要的计量产品（智能电表等业务）产业生产基地，成都开发运营良好，期待在不久的将来发展成为业界具有一定影响力的公司。

关于自动化业务：随着智能制造国家层面的不断推进，制造业向智

能化、数字化发展，公司完成了自动化设备产品从专注计算机与存储领域向EMS行业其它领域扩张，凭借行业内多年来积累的机械、电子、软硬件设计经验，公司自动化产品已经形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化等五个产品系列，致力于提供专业的智能、省人、高效的自动化生产线。

关于工业物联网：公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用，目前自主研发的实时静电防护系统已在惠州、东莞工厂和外部客户工厂应用，并获得内外客户的广泛认可。公司现拥有实时静电防护监控系统（KEDAS）、工业物联网系统（iDAS）、智能工地管理系统（iFOS）、智能离子风机等多项自主研发的工业物联网专利和产品。工业物联网产品未来将成为工业、企业提升综合竞争力的重要手段。公司将在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心部件及平台技术，提供物联网应用开发服务，努力抓住当前的发展机遇，积蓄新的增长动能。

关于医疗产品业务：公司重点客户的主要业务已转移至马来西亚工厂生产，深圳产能已逐渐导入新的医疗产品业务进行填充。目前已成功导入美国、澳大利亚、以色列等多个国家医疗保健产品领域的新客户，并参与到多个产品部件的方案设计研发中，参与研发的多款新产品已逐步实现量产，标志着公司在医疗产品领域的技术实力及生产能力得到了进一步提升。

关于固态存储产品业务：公司通过精益生产持续优化配置内部产线及人员结构，引进自动化生产设备等积极措施有效提升生产效率，降低人力成本，为公司固态存储产品业务降低运营成本。另外，在国家扶持以半导体技术为基础的电子信息技术发展导向下，公司作为中国电子旗下核心的高端制造企业，在依托现有产业平台优势基础上，通过收购沛顿科技进入半导体封装检测领域，推动公司产业链向高附加值的中上游延伸。

关于超级电容产品：公司拥有十余年业务历史，拥有丰富的生产测试经验，具备各类型超级电容整套模组制造解决方案，主要客户为Maxwell和TECATE。为更好的完善供应链，公司与Maxwell展开深度合作，于2018

年初开始导入单体制造生产线，为未来发展奠定了良好的基础。

关于LED业务：开发晶继续在LED外延片/芯片及应用系统研发及产业化方面不断拓展，扩大LED背光模组与照明产品的制造规模，提供多样化的LED照明系统整体解决方案，形成稳定的盈利能力，开发晶通过整合全球资源，将英特美荧光粉与普瑞封装产品相互结合，强化了LED照明品牌配套的价值链竞争力。

关于其他电子产品：公司智能运通事业部的消费级无人机业务开展顺利，并利用现有客户优势积极跟进和导入工业级无人机等产品；公司机器人业务顺利完成试产并获得客户高度认可，目前已进入小量生产；汽车电子业务开拓成果显著，智能传感器业务实现小量生产，未来有望打开业务成长空间。

2、问：请介绍集成电路半导体封装与测试的业务情况？

目前沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端 DRAM / Flash 晶元封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，拥有行业领先的高端封装技术能力，尤其在存储器 DRAM 方面具备世界最新一代的产品封测技术，为国内最大的独立 DRAM 内存芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。目前公司封装测试产品主要包括 DDR3、DDR4 内存颗粒，eMCP、USB、SSD 闪存芯片以及 Fingerprint 指纹芯片等，并具备 wBGA、LPDDR、eMCP、SSD、POP、LGA、TSOP 等封测技术，报告期内，公司新建成 SOP、QFN 等产品线。为把握国内外存储芯片发展机遇，满足市场对高速、低功耗、大容量记忆芯片封装需求，公司正着手推动 DDR5、GDDR5 等产品的应用，未来 DDR5 内存生产所需的倒装封装一站式凸块 FC 封装测试技术将会成为公司的重点部署，并在此基础上发展晶圆级封装、系统级封装及硅穿孔等先进封装技术。2018 年 3 月，公司中标合肥睿力委外封测项目，并持续跟进中。公司未来将不断增强核心竞争力，实现业务的可持续发展。

5、问：医疗业务开展情况？

公司深圳工厂和苏州工厂都顺利获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的产品许可证及生产许可证，未来公司将加大“家用医疗

	<p>产品”及“便携式医疗器械”的研发投入，并对现有产品进行升级，以提升公司未来在该领域内的市场份额和行业影响力。为进一步提升在医疗产品领域的技术实力及生产能力，将在多领域导入智能系统，以交付更有效更安全的产品。</p> <p>3、问：公司今年的通讯与消费电子业务情况？</p> <p>因全球智能手机市场销售数字趋缓，国产智能手机出货量低于去年整体水平。近年来我国劳动力成本逐年上升，作为制造型企业，用工成本的增加已对企业生产经营造成较大程度的影响，2018年通讯业务出现亏损。公司已根据生产布局和发展规划投资桂林子公司，未来将建成桂林智能手机制造基地，可进一步降本增效，提升产品竞争力，对公司通讯与消费电子业务的长远发展将产生积极的影响。</p> <p>4、问：深科技城建设情况？</p> <p>深科技城未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，一期将建有3栋产业研发用楼和商业建筑，计划2020年7月前竣工2栋产业研发楼，2021年12月总部办公楼竣工（具体内容请参阅公司2017年9月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告），目前已完成地下基础工程立柱桩的施工，并按计划有序推进中。深科技城项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2019年1月8日